19 REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INOUSTRIELLE

'ARIS

No de publication la nutiliser que pour le classoment et les communicies de reuresborium à

2.067.825

69.39619

(21) N° d'enregistrement national :
(A utiliser pour les paiements d'annuités, les demandes de copies officielles et toutes autres correspondances avec l'I.N.P.I.)

® BREVET D'INVENTION

PREMIÈRE ET UNIQUE PUBLICATION

(51) Classification internationale (Int. Cl.).. H 05 k 7/00.

71 Déposant : Société anonyme dite : LA TÉLÉPHONIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE «TELIC», résidant en France.

(73) Titulaire : Idem (71)

(74) Mandataire :

Support de composants pour carte de circuits imprimés.

(72) Invention de :

(33) (32) (31) Priorité conventionnelle :

5

40

2067825

L'invention est du domaine des câpleges à limposants discrets sur carte de circuits imprimés. Elle concerne un dispositif annexé à une carte imprimée permettant de loger commodément un grand nombre de composants de petites dimensions. La principale application est dans les circuits logiques de type matriciel.

Il est courant, dans les montages électroniques, en particulier dans les applications de l'électronique à l'industrie téléphonique, d'utiliser des cartes de circuits imprimés sur lesquelles on soude les composants, résistances, capacités, diodes, transistors, etc. On obtient ainsi des montages de faible épaisseur, faciles à associer dans des "paniers" où les cartes sont alignées 10 parallèlement à faible distance l'une de l'autre.

Cependant dans les montages de type répétitif utilisant un grand nombre de composants identiques de petit volume et de faible longueur, si on dispose lesdits composants perpendiculairement à la carte, on réalise une importante économie d'encombrement en surface au prix d'un supplément de hauteur qui n'est 15 pas considérable puisque les composants sont supposés de faible longueur.

C'est dans cet esprit que l'invention prévoit un bloc parallélipipédique portant des rangées d'alvéoles cylindriques de préférence, ayant un diamètre et une hauteur suffisants pour loger des composants de type déterminé, ce bloc recevant sur une face des conducteurs imprimés sur lesquels on peut souder les 20 connexions desdits composants d'un côté, et pouvant se poser sur une carte imprimée sur laquelle on peut souder les connexions des composants dépassant de l'autre côté. 🤄

L'invention va être décrite plus en détail en se référant aux figures annexées, parmi lesquelles :

La figure 1 est une vue perspective en coupe partielle d'un bloc support 25 selon l'invention posé sur une carte imorimée ;

La figure 2 est une vue du dessus d'un bloc portant k rangées de n alvéoles, par exemple dans un cas particulier huit rangées de onze alvéoles :

La figure 3 est une vue du dessous de la partie d'une carte imprimée 30 correspondante, portant o rangées de k trous, par exemple onze rangées de huit trous ;

La figure 4 est une vue en coupe d'un alvéole contenant un composant.

FIGURE 1 - Dans la figure 1, on voit un bloc 8 de l'invention comportent sur la face visible 1 k pistes imprimées conductrices telles que λ (k = 8 par 35 exemple), sur un bord desquelles empiètent les orifices 3 de n alvéoles cylicdriques tels que 4 (n = 11 par exemple). Chacune des pistes de connexion 2 se termine par un point de connexion tel que 5.

le bloc B est fixé sur une face 5 d'une plaque de circuits imprimés C, per exemple par des rivets tels que 7 passant dans des trous tels que 8.

·FIGURE 2 - La figure 2, dans laquelle les références ont même signification

10

2067825

que dans la figure 1, est une vue en plan de la face supérieure 1 d'un bloc de l'invention. Elle comporte k pistes à n trous chacune.

2

FIGURÉ 3 - La figure 3 est une vue en plan par dessous de la face inférieure de la carte imprimée : elle comporte n pistes telles que 9 à k trous tels que 10.

FIGURE 4 - La figure 4 à plus grande échelle est une vue en coupe d'un alvéele 4. Dans l'alvéele est logée un composant 11, par exemple une diode, dont une connexion 12 sortant par un trou 3 est soudée sur une piste 2 sur la face surérieure 1 du bloc. L'autre connexion 13 sortant par un trou 10 de la face inférieure de la carte C est soudée sur une piste 9.

On constitue ainsi des assemblages matriciels.

Une autre solution (non représentée) consiste à laisser les faces du bloc exemptes de connexions imprimées, et à placer le bloc en "sandwich" entre deux cartes de circuits imprimés.

Avantageusement les prifices des alvéoles sur un côté du bloc sont plus 15 étroits que le diamètre des composants, ce qui permet un chargement du bloc avant montage.

On remarquera la facilité avec laquelle les composants peuvent être montés, ou éventuellement changés sur place.

2067825

REVENDICATIONS

1/ Support de composents électroniques destiné au montage sur carte imprimée, caractérisé en ce qu'il comporte un bloc en matière isolente de forme parallélipipédique d'épaisseur relativement faible, de l'ordre de grandeur d'un composant à supporter, comportant des alvéoles percés dans l'épaisseur, de forme cylindrique de préférence, dont chacun peut loger un composant.

2/ Support de composants salon la revendication 1, caractérisé en ce que les orifices des alvéoles débouchant sur une face sont plus étroits que le corps de l'alvéole.

3/ Support selon la revendication 2. caractérisé en ce qu'il comporte sur au moins une fece eu moins une piste conductrice sur laquelle empiètent les orifices desdits alvéoles.

4/ Montage caractérisé en ce qu'il comporte un bloc selon une des revendications 2 ou 3, contenant des composants à deux fils de connexion logés dans lesdits alvéoles, dont un fil de connexion est soudé sur une desdites pistes conductrices, et posé sur une carte de circuits imprimés portant des trous correspondant aux alvéoles et au moins une piste conductrice sur la face inférieure, sur laquelle sont soudés les autres fils de connexion desdits composants.

Pl. unique

2067825

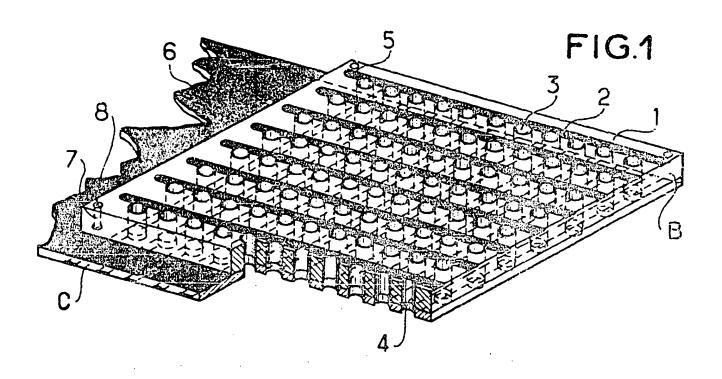


FIG.2

FIG.3

FIG.3

FIG.3

POR PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

FIG.4

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.